



電紫外線 3D 列印設計技巧

- 首選文件類型：Gerber 文件轉換為 PDF 格式。
- 最小線寬：100 微米。
- 最小間距：200 微米，邊緣到邊緣。
- 不僅要注意走線之間的間距，還要注意走線與鑽孔/過孔之間的間距。
 - 建議間距：~ 200 微米，走線邊緣到過孔壁。
 - 走線距離過孔過近可能會導致層間短路，因為導電油墨可能會意外滲漏下去。
- 鑽孔，本質上是印刷標準鑽孔檔案的反轉影像，在層中留下空隙作為過孔。
 - 最小通孔尺寸：直徑 200 微米。
- 阻焊層 可以使用與絕緣層相同的介電材料進行印刷。
- 外部基準點對於對準目的非常有用。
 - 至少使用 1 個貫穿所有層的外部基準點，以便在軟體中以及實際建置過程中更輕鬆地進行層與層之間的對齊。
- 如果可能的話，使用斜紋底面可以減少銀墨的消耗。
- 對於將要安裝元件的焊盤：
 - 建議印刷額外的銀層，以便為焊接提供堅實的基礎。
 - 對於這些重複的焊盤堆疊層，建議使用單獨的文件，其中只包含要焊接的焊盤，並且焊盤縮小約 20%，以彌補堆疊過程中可能出現的任何擴散。
- 對於電源走線：
 - 與元件連接焊盤的概念相同，只需列印一個僅包含電源走線的單獨文件，即可根據設計規範的要求重複列印。
- 一般基質推薦：
 - 最常見的材料：Kapton/聚醯亞胺、FR4 板、PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）。
 - 任何平面，無論是剛性的還是柔性的。
 - 如果黏合性有問題，可以列印介電基底層，或使用我們的擦拭型底漆來增強黏合性。
- 使用前端印表機軟體中的功能可以完成基本的文件/設計操作，從而可以快速修改設計方面的某些內容，例如：
 - 擴大/縮小過孔。
 - 加粗/減細線條。
 - 新增/刪除基本資訊。



PHONE: +1 646-775-4976

EMAIL: info@3dworldtech.com

WEBSITE: chemcubed.com

©2024 ChemCubed, LLC All rights reserved. All specifications subject to change at any time without notice.
Please consult your sales representative for most current information.